



平成27年12月期 決算短信〔日本基準〕(連結)

平成28年2月12日 東

上場会社名 株式会社RS Technologies 上場取引所
 コード番号 3445 URL <http://www.rs-tec.jp>
 代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 方 永義
 問合せ先責任者 (役職名) 取締役管理本部長 (氏名) 鈴木 正行 (TEL) 03(5709)7685
 定時株主総会開催予定日 平成28年3月29日 配当支払開始予定日 —
 有価証券報告書提出予定日 平成28年3月29日
 決算補足説明資料作成の有無 : 有
 決算説明会開催の有無 : 有 (アナリスト・機関投資家向け)

(百万円未満切捨て)

1. 平成27年12月期の連結業績(平成27年1月1日～平成27年12月31日)

(1) 連結経営成績 (%表示は対前期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		当期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
27年12月期	5,545	21.4	1,081	△7.3	937	△24.8	304	△54.2
26年12月期	4,566	—	1,166	—	1,247	—	664	—

(注) 包括利益 27年12月期 284百万円(△59.0%) 26年12月期 694百万円(—%)

	1株当たり 当期純利益	潜在株式調整後 1株当たり 当期純利益	自己資本 当期純利益率	総資産 経常利益率	売上高 営業利益率
	円 銭	円 銭	%	%	%
27年12月期	56.72	55.04	14.6	11.3	19.5
26年12月期	131.90	—	43.3	18.3	25.5

(参考) 持分法投資損益 27年12月期 -百万円 26年12月期 -百万円

- (注) 1. 当社は、平成25年12月期については、連結財務諸表を作成していないため、平成26年12月期の対前期増減率については記載しておりません。また、「自己資本当期純利益率」及び「総資産経常利益率」は連結初年度のため、それぞれ期末自己資本及び期末総資産に基づいて算出しております。
2. 当社は、平成26年9月9日付けで株式1株につき500株の株式分割を行っており、前連結会計年度の期首に分割が行われたと仮定して、「1株当たり当期純利益」を算定しております。
3. 当社は、平成27年3月24日に東京証券取引所マザーズ市場に上場したため、平成27年12月期会計年度の「潜在株式調整後1株当たり当期純利益」は、新規上場日から平成27年12月期会計年度末までの平均株価を期中平均株価とみなして算定しております。

(2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率	1株当たり純資産
	百万円	百万円	%	円 銭
27年12月期	9,737	2,644	27.1	485.54
26年12月期	6,823	1,596	22.5	300.54

(参考) 自己資本 27年12月期 2,638百万円 26年12月期 1,535百万円

- (注) 当社は、平成26年9月9日付けで株式1株につき500株の株式分割を行っており、前連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して「1株当たり純資産」を算定しております。

(3) 連結キャッシュ・フローの状況

	営業活動による キャッシュ・フロー	投資活動による キャッシュ・フロー	財務活動による キャッシュ・フロー	現金及び現金同等物 期末残高
	百万円	百万円	百万円	百万円
27年12月期	470	△2,127	2,327	1,603
26年12月期	643	△3,215	3,066	951

2. 配当の状況

	年間配当金					配当金総額 (合計)	配当性向 (連結)	純資産 配当率 (連結)
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計			
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	百万円	%	%
26年12月期	—	0.00	—	0.00	0.00	—	—	—
27年12月期	—	0.00	—	0.00	0.00	—	—	—
28年12月期(予想)	—	0.00	—	0.00	0.00	—	—	—

3. 平成28年12月期の連結業績予想(平成28年1月1日～平成28年12月31日)

(%表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属 する当期純利益		1株当たり 当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
第2四半期(累計)	3,196	29.1	454	△25.4	414	△28.9	217	△7.5	40.56
通期	7,031	26.8	1,464	35.5	1,382	47.4	986	224.2	183.89

※ 注記事項

(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）： 無

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

- ① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更： 無
 ② ①以外の会計方針の変更： 無
 ③ 会計上の見積りの変更： 無
 ④ 修正再表示： 無

(3) 発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む）	27年12月期	5,440,000株	26年12月期	5,110,000株
② 期末自己株式数	27年12月期	6,700株	26年12月期	—株
③ 期中平均株式数	27年12月期	5,364,251株	26年12月期	5,036,164株

- (注) 1. 当社は、平成26年9月9日付で普通株式1株につき、500株の割合で株式分割を実施いたしました。当連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して株式数を算定しております。
 2. 自己株式数は、「従業員持株E S O P信託口」が保有する当社株式（27年12月期：6,700株）であります。また、期中平均株式数の計算において控除する自己株式数は、「従業員持株E S O P信託口」が保有する当社株式であります。（2,516株）

(参考) 個別業績の概要

1. 平成27年12月期の個別業績（平成27年1月1日～平成27年12月31日）

(1) 個別経営成績 (%表示は対前期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		当期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
27年12月期	5,752	26.0	1,425	19.8	1,364	5.4	801	12.8
26年12月期	4,566	31.4	1,190	69.4	1,293	58.0	710	35.3
	1株当たり 当期純利益		潜在株式調整後 1株当たり当期純利益					
	円 銭		円 銭					
27年12月期	149.35		144.92					
26年12月期	141.00		—					

(注) 当社は、平成26年9月9日付で株式1株につき500株の株式分割を行っており、前事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、「1株当たり当期純利益」を算定しております。

(2) 個別財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率	1株当たり純資産
	百万円	百万円	%	円 銭
27年12月期	7,896	3,182	40.2	584.68
26年12月期	6,046	1,557	25.8	304.86

(参考) 自己資本 27年12月期 3,176百万円 26年12月期 1,557百万円

(注) 当社は、平成26年9月9日付で株式1株につき500株の株式分割を行っており、前事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して「1株当たり純資産」を算定しております。

※ 監査手続の実施状況に関する表示

この決算短信は、金融商品取引法に基づく監査手続の対象外であり、この決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく財務諸表の監査手続は終了していません。

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現時点で入手している情報及び合理的であると判断する前提に基づいたものであり、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、添付資料2ページ「1. 経営成績・財政状態に関する分析(1)経営成績に関する分析②次期の見通し」をご覧ください。

○添付資料の目次

1. 経営成績・財政状態に関する分析	2
(1) 経営成績に関する分析	2
(2) 財政状態に関する分析	2
(3) 利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当	4
(4) 事業等のリスク	5
2. 経営方針	7
(1) 会社の経営の基本方針	7
(2) 目標とする経営指標	7
(3) 中長期的な会社の経営戦略	7
(4) 会社の対処すべき課題	7
3. 会計基準の選択に関する基本的な考え方	8
4. 連結財務諸表	9
(1) 連結貸借対照表	9
(2) 連結損益計算書及び連結包括利益計算書	11
(3) 連結株主資本等変動計算書	13
(4) 連結キャッシュ・フロー計算書	14
(5) 連結財務諸表に関する注記事項	15
(継続企業の前提に関する注記)	15
(セグメント情報等)	15
(1株当たり情報)	17
(重要な後発事象)	17

1. 経営成績・財政状態に関する分析

(1) 経営成績に関する分析

①当期の経営成績

当連結会計年度における世界経済は、米国経済が緩やかに回復していたものの、中国及び新興国の景気減速による影響などから先行きは不透明感が続いております。一方、わが国経済は、政府による景気対策、日銀の金融緩和などから企業収益や雇用情勢の改善が続き底堅く推移いたしました。

当社グループを取り巻く事業環境は、当社グループの主要マーケットの一部であります台湾市場の大幅な需要減少がありました。しかしながら当社の従来からの強みである欧州、米国、日本市場でのシェア拡大や新規需要の取り込みを行い、三本木工場の生産能力拡大分の受注を確保しております。

設備投資につきましては、半導体ウェーハ再生市場のシェア拡大のため三本木工場及び台湾子会社工場の移設・新設を進め、生産能力の増強を図りました。三本木工場内の新規設備は6月に稼働を開始いたしました。台湾子会社工場は、顧客先の認定待ちなどにより本格稼働とはなっておりませんが、売上高は、既存工場を効率的に代替稼働していることと半導体生産設備の販売、半導体の関連材料販売、為替の円安効果などにより概ね計画通りに進みました。

このような状況の中、当連結会計年度における当社グループの売上高は5,545,500千円（前年同期比21.4%増）となりました。営業利益は1,081,308千円（前年同期比7.3%減）となり、為替差損として営業外費用53,135千円を計上したことなどから経常利益は937,865千円（前年同期比24.8%減）、三本木工場及び台湾子会社工場の設備移転・新設に係る立ち上げ費用などにより当期純利益は304,248千円（前年同期比54.2%減）となりました。

事業のセグメント別の業績を示すと次のとおりです。

なお、当社グループは、当連結会計年度より、「ソーラー事業」の金額的重要性が乏しくなったため、報告セグメントの区分については、当該事業を「その他」に含めて記載する方法に変更しております。なお、当連結会計年度から「半導体の関連材料販売」を行っておりますが重要性がないため「その他」に含めております。前期比較については、前期の数値を変更後のセグメント区分に組み替えた数値で比較しております。

(ウェーハ事業)

当事業におきましては、再生市場の需要が堅調に推移したことなどから売上高は5,107,008千円（前年同期比15.7%増）、営業利益は1,386,332千円（前年同期比4.1%減）となりました。

(その他)

その他におきましては、ソーラー事業、半導体生産設備の買取・販売及び半導体の関連材料販売と技術コンサルティングの業績を示しており、外部顧客への売上高は438,491千円（前年同期比189.2%増）、営業利益は164,435千円（前年同期比168.3%増）となりました。

②次期の見通し

当社グループは、三本木工場の新規生産ラインの稼働、国内工場で培ってきた生産技術と生産方法による台湾工場の本稼働と国内・海外のシリコンウェーハ再生事業の更なる拡大を目指してまいります。

次期（平成28年12月期）の連結業績見通しにつきましては、売上高70億31百万円（前期比26.8%増）、営業利益14億64百万円（前期比35.5%増）、経常利益13億82百万円（前期比47.4%増）、親会社株主に帰属する当期純利益9億86百万円（前期比224.2%増）を見込んでおります。

(2) 財政状態に関する分析

(資産、負債及び純資産の状況)

(資産の部)

当連結会計年度末における流動資産は3,892,627千円となり、前連結会計年度末と比較して1,133,310千円増加いたしました。これは主に、現金及び預金652,246千円、受取手形及び売掛金274,109千円、繰延税金資産328,880千円の増加によるものであります。

固定資産は5,845,109千円となり、前連結会計年度末と比較して1,780,786千円増加いたしました。これは主に有形固定資産1,749,208千円、投資その他の資産17,931千円増加したことによるものであります。

この結果、総資産は9,737,737千円となり、前連結会計年度末に比べて2,914,097千円増加いたしました。

(負債の部)

当連結会計年度末における流動負債は2,295,613千円となり、前連結会計年度末と比較して2,758千円増加いたしました。これは主に、支払手形及び買掛金34,941千円の増加、短期借入金130,180千円の減少、1年内返済予定の長期借入金519,246千円の増加、未払法人税等399,373千円の減少によるものであります。

固定負債は4,798,001千円となり、前連結会計年度末と比較して1,863,312千円増加いたしました。これは主に、長期借入金1,153,483千円、繰延税金負債709,335千円の増加によるものであります。

この結果、負債合計は7,093,615千円となり、前連結会計年度末に比べ1,866,070千円増加いたしました。

(純資産の部)

当連結会計年度末における純資産は2,644,121千円となり、前連結会計年度末と比較して1,048,026千円増加いたしました。これは主に公募増資による資金調達834,900千円、当期純利益304,248千円によるものであります。

(キャッシュ・フローの状況)

当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）の残高は、前連結会計年度より652,676千円増加し、残高は1,603,704千円（68.6%増）となりました。

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

①営業活動によるキャッシュ・フロー

当連結会計年度において営業活動の結果増加した資金は470,273千円となりました。

主な増加要因は、税金等調整前当期純利益688,825千円を計上したことによるものです。また主な減少要因は利息の支払額80,503千円、法人税等の支払額143,946千円によるものであります。

②投資活動によるキャッシュ・フロー

当連結会計年度において投資活動の結果減少した資金は2,127,740千円となりました。

主な減少要因は、シリコンウェーハ製造設備及び研究開発設備等に伴う有形固定資産の取得による支出4,537,635千円によるものであります。また主な増加要因は、国庫補助金の受取額2,443,047千円によるものであります。

③財務活動によるキャッシュ・フロー

当連結会計年度において財務活動の結果増加した資金は2,327,368千円となりました。

主な増加要因は、長期借入れによる収入4,924,027千円及び株式の発行による収入814,852千円によるものであります。また主な減少要因は、短期借入金の減少額124,680千円及び長期借入金の返済による支出3,271,637千円によるものであります。

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移

	平成26年12月期	平成27年12月期
自己資本比率 (%)	22.5	27.1
時価ベースの自己資本比率 (%)	-	119.4
キャッシュ・フロー対有利子負債比率 (年)	5.8	11.3
インタレスト・カバレッジ・レシオ (倍)	26.2	5.8

自己資本比率：自己資本/総資産

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額/総資産

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債/営業キャッシュ・フロー

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー/利払い

(注1) いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。

(注2) 株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式総数（自己株式控除後）により算出しております。

(注3) キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しております。

(注4) 有利子負債は連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っているすべての負債を対象としております。

(注5) 利払いは、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。

(3) 利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

当期末の配当につきましては、今後も継続して設備投資を実施して行く必要があることから、当面は必要な内部留保を確保しつつ、配当は実施せず、設備投資の継続に備えて資金の確保を優先する方針であります。また、次期の配当につきましても同様とさせていただく予定であります。しかしながら、株主に対する利益の還元は当社にとって最も重要な経営の課題として認識しており、財務体質の改善・強化及び中期計画の達成等の状況を勘案しながら配当を実施することを検討してまいります。

(4) 事業等のリスク

本書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項には、以下のようなものがあります。また、以下の記載は投資に関連するリスクを全て網羅するものでない点に留意する必要があります。なお、文中の将来に関する事項は、本書提出日現在において当社グループが判断したものであります。

① 特定の取引先への依存に関するリスク

当社グループは、世界有数の半導体受託生産企業であるTaiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd (TSMC)との円滑な取引を継続しており、同社に対する売上高が当社グループの売上高に占める割合は、第5期事業年度38.3%、第6期連結会計年度26.6%と高い割合となっております。

従って、同社の販売及び設備投資の動向によっては当社グループの経営成績に影響を与える可能性があります。

② 業界動向に関するリスク

当社グループの主な需要先は半導体業界であります。需給の変動があった場合、シリコンウェーハの使用量の減少や販売価格の低下により当社グループの経営成績に影響を与える可能性があります。

③ 他社との競合に関するリスク

当社グループの主たる事業領域である半導体市場は、国内外を問わず厳しい競合環境にあり、同業他社との間では価格、品質、顧客対応能力、新製品開発力等、様々な局面での競争が展開されています。

当社グループは、ウェーハ事業において高い価格競争力を有する様々なテスト用半導体ウェーハを手掛けることにより、収益源を確保すると共に半導体需給や技術動向の把握及び顧客層や製品分野の拡大を図っていますが、高シェア製品の市場支配力が低下することにより競争上の地位が低下した場合、当社グループの事業、経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

④ 外注先の品質管理に関するリスク

当社グループは、ウェーハ事業の加工工程を外部企業に一部委託しています。当社グループでは、委託先企業の経営状況、技術水準、製造能力について継続的に監視していますが、委託先企業が、必要な技術的・経済的資源を維持するとともに十分な製品の品質を保ち、当社グループが求める水準の委託業務を遂行できる保証はありません。

また、これらの委託先において何らかの理由により事業が中断された場合、当社グループ製品の加工及び製品の供給に影響を及ぼす可能性があります。

⑤ 加工工程に関するリスク

当社グループの主たる事業領域である半導体市場では、製品価格が継続的に低下する傾向にあります。当社グループでは、生産プロセスの見直し等により生産効率の向上を進め、製品価格低下の影響を緩和するように努めていますが、一般的に生産効率の向上には限界があるため、製品価格の低下が続き、かつ、継続的に生産効率を向上させることができなくなった場合、利益が圧迫される可能性があります。さらに、加工工程において、何らかの理由により加工活動が中断してしまった場合、生産能力低下や納期遅延が発生し、ウェーハの供給が困難となる可能性があり、当社グループの事業、経営成績及び財政状態に影響を与えるリスクがあります。

⑥ 設備投資及び資金調達に関するリスク

当社グループは、市場動向、需要動向等を見極めながら、事業戦略及び当該投資の収益性等を勘案しつつ必要な設備投資を実施していく方針です。

大規模な設備投資を行った場合、製造ラインの調整等を行う必要があることから、本格的な生産に至るまでには一定の期間を要するため、減価償却費が先行的に発生することになります。

また、取得を予定している半導体検査装置、半導体洗浄装置等の各種製造設備については、現在の当社の収益規模及び財務規模と比較すると相対的に高額の水準となっており、今後減価償却費が大幅に増加する可能性があります。

これらの要因により、今後当社グループの利益率が大幅に悪化する可能性があります。また、当該設備投資を行う際に想定していた受注を期待通りに獲得できなかった場合には、当社グループの経営成績等は重大な影響を受ける可能性があります。

また、当社グループは、事業展開の必要に応じて機動的な資金調達を実施していく方針ですが、当該資金調達に際しては、当社グループの財政状態、収益性等のほか、金利水準や市場環境等の要因により、当社グループが希望する時期または条件により資金調達を実行できない場合があり、そのような場合には、必要な設備投資を行うことができ

ず、事業計画等において想定していた収益を上げられない可能性があり、当社グループの事業、経営成績及び財政状態に重大な影響を与えるリスクがあります。

⑦ 為替の変動に関するリスク

当社グループの取引先は国内外の半導体メーカーを中心としていることから、輸出比率は、第5期事業年度73.7%、第6期連結会計年度61.8%と高い水準で推移しており、為替変動の影響を強く受けております。このため、為替相場の急激な変動によっては当社グループの経営成績に影響を与える可能性があります。

⑧ 配当政策に関するリスク

当社グループは、将来の事業展開と経営体質の強化のために必要な内部留保を確保しつつ、安定した配当を継続して実施していくことを基本方針としておりますが、設立以来、財務体質の改善・強化を優先し、配当を実施しておりません。また今後も継続して設備投資を実施して行く必要があることから、当面は必要な内部留保を確保しつつ、配当は実施せず、設備投資の継続に備えて資金の確保を優先する方針であります。しかしながら、株主に対する利益の還元を経営の重要課題として認識しており、財務体質の改善・強化及び設備投資の状況を勘案しながら配当を実施することを検討していきます。

⑨ 特定人物への依存に関するリスク

現在、当社グループの経営は代表取締役社長である方永義を含めた8名の取締役と3名の監査役で構成される経営陣で運営されており、代表取締役社長である方永義個人に依存した組織ではありません。しかしながら、同氏は、前職（株式会社永輝商事代表取締役）までの経営者としての経験・人脈を生かし、当社グループの新規営業先の開拓、グローバルな事業展開において重要な役割を果たしております。従いまして、何らかの理由により同氏の業務遂行が困難となった場合には、当社グループの業績に重要な影響を及ぼす可能性があります。

⑩ 事故、災害等による操業への影響に関するリスク

当社グループの生産設備の中には、ウェーハ事業の炉など高温、高圧での操業を行なっている設備があります。また、ウェーハを加工するうえで多量の化学薬品等を取り扱っています。対人・対物を問わず、事故の防止対策には万全を期しておりますが、万一重大な事故が発生した場合には、当社グループの事業、経営成績及び財政状態に影響を与えるリスクがあります。また、国内外の製造拠点等において、大規模地震や台風等の自然災害、新型インフルエンザ等の感染症、その他当社グループの制御不能な事態により操業に支障が生じた場合には、当社グループの事業、経営成績及び財政状態に影響を与えるリスクがあります。

⑪ 財務制限条項に関するリスク

当社は、事業に必要な資金調達のため、平成26年3月に金融機関との間でコミットメント期間付タームローン及びシンジケートローン契約を締結しており、これらの借入契約には、純資産の維持及び経常利益の確保に関して財務制限条項が付加されております。今後、当社グループの経営成績が著しく悪化するなどして財務制限条項に抵触した場合、借入先金融機関の請求により当該借入について期限の利益を喪失し、一括返済を求められるなどして、財政状況及び業績等に影響を及ぼす可能性があります。

⑫ 有利子負債への依存及び金利水準の動向に関するリスク

当社グループは、主に金融機関からの借入金によって事業資金を調達しており、総資産に占める有利子負債の割合は、第6期連結会計年度において54.4%であります。当社グループでは、金利等の動向を注視しつつ、将来の環境変化にも柔軟な対応が可能な調達形態の維持・構築に努めております。しかしながら、事業の規模拡大に伴う資金需要により、有利子負債の割合が上昇するとともに、金利水準の上昇により、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

2. 経営方針

(1) 会社の経営の基本方針

当社は、「地球環境を大切にし、世界の人々に信頼され、常に創造し挑戦する」ことを経営の基本理念とし、「多様性を尊重し、自由闊達な企業風土をつくり、「就業環境No.1」を目指す」「エコロジー事業を通して環境に優しい総合エコソリューション企業として世界をリードし、人々の豊かな生活に貢献する」「公正、信用を重視し、社会を利する事業を進める」ことを行動指針としております。当社は、この経営の基本理念及び行動指針に従い、社会的な責任を遂行し企業価値を最大化することを経営方針としております。

(2) 目標とする経営指標

当社グループは、更なる成長を続けることにより企業価値の最大化を図るため、売上高、売上高営業利益率、1株当たり当期純利益、ROE（自己資本利益率）、ROA（総資本利益率）を重要な経営指標としております。

(3) 中長期的な会社の経営戦略

当社の事業は半導体の市場と相関がありますが、半導体デバイスは、パソコン、携帯電話、スマートフォン、ゲーム機、デジタル家電へと急速に広がり、そうした機器の需要は世界的に拡大しております。

今後も、世界人口の増加と新興国の経済発展に伴う需要、及び先進国の更なるデバイス用途（ロボットの多様化・自動車・家・街・M2M・・・等）の広がりにより、増加が継続することが予測されております。

半導体需要の増加に伴い、その基盤となるシリコンウェーハもまた需要が拡大し、再生需要も増加が予測されております。

現在、顧客需要に対し供給不足となっております。中期的には、三本木工場の増設及び台湾工場の新設と大規模な設備投資により生産力を増強します。

三本木工場は平成27年6月から、台湾工場は平成27年12月から稼働しました。従来の生産力に比較して70%増となります。また、三本木工場の新規設備には次世代の18インチ（450mm）ウェーハの加工装置も含まれており、世界に先駆けて製造を行う予定であります。

長期的には、増設・新設後の工場をフル稼働し、再生市場でのシェア拡大を目指します。

(4) 会社の対処すべき課題

当社グループの主要な事業であるシリコンウェーハの再生事業は、半導体市場の影響を受けます。足許において、世界の長期的な半導体需要は増加傾向にあり、半導体メーカーからの需要も増加しております。このようななか、当社グループとしては国内国外を問わず半導体メーカーの需要を取り込む必要があります。また、日々進歩している微細化技術の開発や18インチ（450mm）ウェーハの開発等の技術革新にも対応していく必要があります。当社グループはこのような経営環境の中で以下の事項を対処すべき課題として認識しております。

① 技術開発

- a. 世界最先端の微細化技術に適應する12インチ（300mm）ハイエンド向け再生技術を開発、事業化すること。
- b. 18インチ（450mm）ウェーハの再生技術を開発、事業化すること。

② 営業施策

- a. アメリカ・欧州・台湾・シンガポール・中国・韓国をはじめとする海外との取引を更に強化すること。
- b. 大手半導体デバイスメーカーとの安定的取引を確保すること。
- c. モニタウェーハ及びターゲット材（※）・ケミカル消耗品の販売を強化すること。
- d. 半導体関連商品の販売を強化すること。

③ 製造体制

- a. 半導体デバイスの高集積度化に対応すること。
- b. 最先端設備を拡充すること。
- c. 高度な知識・技能を有する人材を確保すること。

④ 海外進出

- a. 主要な半導体メーカーの需要に適時に対応するため海外進出をすること。

※ターゲット材 半導体を加工する時の補助材料

3. 会計基準の選択に関する基本的な考え方

当社グループは、連結財務諸表の期間比較可能性及び企業間の比較可能性を考慮し、当面は、日本基準で連結財務諸表を作成する方針であります。

なお、IFRSの適用につきましては、国内外の諸情勢を考慮の上、適切に対応していく方針であります。

4. 連結財務諸表

(1) 連結貸借対照表

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成26年12月31日)	当連結会計年度 (平成27年12月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	1,190,277	1,842,523
受取手形及び売掛金	696,764	970,873
商品及び製品	376,262	346,599
仕掛品	67,869	123,123
原材料及び貯蔵品	79,532	146,355
繰延税金資産	50,141	379,022
その他	298,468	84,129
流動資産合計	2,759,317	3,892,627
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物	8,756	1,524,855
減価償却累計額	△1,777	△19,101
建物及び構築物 (純額)	6,978	1,505,754
機械装置及び運搬具	659,915	4,196,335
減価償却累計額	△298,311	△588,815
機械装置及び運搬具 (純額)	361,604	3,607,520
工具、器具及び備品	7,499	82,437
減価償却累計額	△1,411	△8,482
工具、器具及び備品 (純額)	6,088	73,954
建設仮勘定	3,543,784	480,434
有形固定資産合計	3,918,455	5,667,664
無形固定資産		
ソフトウェア	15,489	29,136
無形固定資産合計	15,489	29,136
投資その他の資産		
長期貸付金	65,699	—
その他	64,677	148,308
投資その他の資産合計	130,377	148,308
固定資産合計	4,064,322	5,845,109
資産合計	6,823,640	9,737,737

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成26年12月31日)	当連結会計年度 (平成27年12月31日)
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	151,225	186,167
短期借入金	483,180	353,000
1年内返済予定の長期借入金	344,049	863,295
未払金	767,303	732,078
未払法人税等	408,323	8,949
賞与引当金	11,449	22,311
その他	127,324	129,810
流動負債合計	2,292,855	2,295,613
固定負債		
長期借入金	2,925,959	4,079,442
繰延税金負債	7,750	717,086
その他	979	1,472
固定負債合計	2,934,689	4,798,001
負債合計	5,227,545	7,093,615
純資産の部		
株主資本		
資本金	199,000	616,450
資本剰余金	198,990	616,440
利益剰余金	1,114,008	1,418,257
自己株式	—	△17,094
株主資本合計	1,511,998	2,634,052
その他の包括利益累計額		
為替換算調整勘定	23,776	4,055
その他の包括利益累計額合計	23,776	4,055
新株予約権	—	6,013
少数株主持分	60,320	—
純資産合計	1,596,094	2,644,121
負債純資産合計	6,823,640	9,737,737

(2) 連結損益計算書及び連結包括利益計算書

連結損益計算書

(単位：千円)

	前連結会計年度 (自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日)	当連結会計年度 (自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日)
売上高	4,566,080	5,545,500
売上原価	2,746,263	3,673,492
売上総利益	1,819,817	1,872,007
販売費及び一般管理費	653,736	790,698
営業利益	1,166,080	1,081,308
営業外収益		
受取利息	623	1,012
為替差益	207,531	—
補助金収入	44,469	19,563
その他	6,083	11,742
営業外収益合計	258,707	32,317
営業外費用		
支払利息	28,098	85,956
為替差損	—	53,135
シンジケートローン手数料	125,120	—
その他	23,623	36,668
営業外費用合計	176,841	175,760
経常利益	1,247,946	937,865
特別利益		
国庫補助金収入	—	2,443,047
特別利益合計	—	2,443,047
特別損失		
設備移設費用	19,643	249,040
固定資産圧縮損	—	2,443,047
特別損失合計	19,643	2,692,087
税金等調整前当期純利益	1,228,303	688,825
法人税、住民税及び事業税	610,073	4,404
法人税等調整額	△46,031	380,171
法人税等合計	564,042	384,576
少数株主損益調整前当期純利益	664,261	304,248
当期純利益	664,261	304,248

連結包括利益計算書

	(単位：千円)	
	前連結会計年度 (自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日)	当連結会計年度 (自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日)
少数株主損益調整前当期純利益	664,261	304,248
その他の包括利益		
為替換算調整勘定	30,176	△19,400
その他の包括利益合計	30,176	△19,400
包括利益	694,437	284,848
(内訳)		
親会社株主に係る包括利益	688,037	284,848
少数株主に係る包括利益	6,400	—

(3) 連結株主資本等変動計算書

前連結会計年度(自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日)

(単位:千円)

	株主資本				その他の包括利益累計額		少数株主持分	純資産合計
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	株主資本合計	為替換算調整勘定	その他の包括利益累計額合計		
当期首残高	100,000	99,990	449,747	649,737	—	—	—	649,737
当期変動額								
新株の発行	99,000	99,000		198,000				198,000
自己株式の取得				—				—
自己株式の処分				—				—
当期純利益			664,261	664,261				664,261
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)					23,776	23,776	60,320	84,096
当期変動額合計	99,000	99,000	664,261	862,261	23,776	23,776	60,320	946,357
当期末残高	199,000	198,990	1,114,008	1,511,998	23,776	23,776	60,320	1,596,094

当連結会計年度(自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日)

(単位:千円)

	株主資本					その他の包括利益累計額		新株予約権	少数株主持分	純資産合計
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	自己株式	株主資本合計	為替換算調整勘定	その他の包括利益累計額合計			
当期首残高	199,000	198,990	1,114,008	—	1,511,998	23,776	23,776	—	60,320	1,596,094
当期変動額										
新株の発行	417,450	417,450			834,900					834,900
自己株式の取得				△19,901	△19,901					△19,901
自己株式の処分				2,806	2,806					2,806
当期純利益			304,248		304,248					304,248
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)						△19,720	△19,720	6,013	△60,320	△74,027
当期変動額合計	417,450	417,450	304,248	△17,094	1,122,054	△19,720	△19,720	6,013	△60,320	1,048,026
当期末残高	616,450	616,440	1,418,257	△17,094	2,634,052	4,055	4,055	6,013	—	2,644,121

(4) 連結キャッシュ・フロー計算書

	(単位：千円)	
	前連結会計年度 (自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日)	当連結会計年度 (自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前当期純利益	1,228,303	688,825
減価償却費	102,535	326,319
受取利息及び受取配当金	△623	△1,012
補助金収入	△44,469	△19,563
国庫補助金収入	—	△2,443,047
為替差損益 (△は益)	△82,820	56,746
支払利息	28,098	85,956
株式公開費用	—	14,292
シンジケートローン手数料	125,120	—
固定資産圧縮損	—	2,443,047
売上債権の増減額 (△は増加)	△17,987	△279,691
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△85	△217,857
仕入債務の増減額 (△は減少)	12,452	35,395
未払金の増減額 (△は減少)	△51,348	15,058
未収消費税等の増減額 (△は増加)	△133,017	△18,360
賞与引当金の増減額 (△は減少)	1,260	11,146
その他	△55,683	△23,184
小計	1,111,735	674,072
利息及び配当金の受取額	221	1,087
補助金の受取額	44,469	19,563
利息の支払額	△24,593	△80,503
法人税等の支払額	△488,481	△143,946
営業活動によるキャッシュ・フロー	643,351	470,273
投資活動によるキャッシュ・フロー		
定期預金の預入による支出	△217,922	—
有形固定資産の取得による支出	△2,901,031	△4,537,635
無形固定資産の取得による支出	△1,276	△15,025
貸付けによる支出	△56,058	—
貸付金の回収による収入	—	1,917
敷金及び保証金の差入による支出	△32,265	△8,441
保険積立金の積立による支出	△7,225	△7,219
国庫補助金の受取額	—	2,443,047
その他	△13	△4,383
投資活動によるキャッシュ・フロー	△3,215,793	△2,127,740
財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入金の純増減額 (△は減少)	470,180	△124,680
長期借入れによる収入	2,619,298	4,924,027
長期借入金の返済による支出	△146,904	△3,271,637
株式の発行による収入	196,447	814,852
シンジケートローン手数料の支払額	△125,120	—
自己株式の取得による支出	—	△19,901
自己株式の売却による収入	—	2,589
少数株主からの払込みによる収入	53,920	—
その他	△827	2,116
財務活動によるキャッシュ・フロー	3,066,993	2,327,368
現金及び現金同等物に係る換算差額	78,480	△17,224
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	573,032	652,676
現金及び現金同等物の期首残高	377,995	951,027
現金及び現金同等物の期末残高	951,027	1,603,704

(5) 連結財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前提に関する注記)

該当事項はありません。

(セグメント情報等)

(セグメント情報)

1 報告セグメントの概要

当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。

当社グループは、報告セグメントを「ウェーハ事業」及び「ソーラー事業」の2事業としております。「ウェーハ事業」は、半導体用シリコンウェーハの再生、加工及び販売を行っております。「ソーラー事業」は、自社工場メガソーラー発電所による売電を行っております。

当社グループは、当連結会計年度より、「ソーラー事業」の金額的重要性が乏しくなったため、報告セグメントの区分については、当該事業を「その他」に含めて記載する方法に変更しております。なお、当連結会計年度から「半導体の関連材料販売」を行っておりますが重要性がないため「その他」に含めております。

なお、前連結会計年度のセグメント情報については、変更後の区分方法により作成しており、前連結会計年度の「3. 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報」に記載しております。

2 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法

報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と概ね同一であります。

3 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報

前連結会計年度(自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日)

(単位：千円)

	報告セグメント	その他 (注) 1	合計	調整額 (注) 2	連結財務諸表 計上額
	ウェーハ事業				
売上高					
外部顧客への売上高	4,414,457	151,623	4,566,080	-	4,566,080
セグメント間の内部 売上高又は振替高	-	-	-	-	-
計	4,414,457	151,623	4,566,080	-	4,566,080
セグメント利益	1,444,913	61,293	1,506,207	△340,126	1,166,080
セグメント資産	5,040,036	382,451	5,422,488	1,401,151	6,823,640
その他の項目					
減価償却費	83,740	14,861	98,601	3,933	102,535
減損損失	-	-	-	-	-
有形固定資産及び無 形固定資産の増加額	3,555,426	-	3,555,426	1,276	3,556,703

(注) 1. 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、ソーラー事業、半導体生産設備の買取・販売と技術コンサルティングであります。

2. 調整額は以下のとおりであります。

(1) セグメント利益の調整額は、各報告セグメントには配賦していない全社費用であります。

全社費用は、報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

(2)セグメント資産の調整額は、各報告セグメントに配賦していない全社資産であります。

全社資産は主に報告セグメントに帰属しない現金及び預金並びに管理部門に係る資産等であります。

(3)減価償却費の調整額は、全社資産に係る減価償却費であります。

(4)有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、全社資産に係る増加額であります。

3.セグメント利益は連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

当連結会計年度(自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日)

(単位：千円)

	報告セグメント	その他 (注) 1	合計	調整額 (注) 2	連結財務諸表 計上額
	ウェーハ事業				
売上高					
外部顧客への売上高	5,107,008	438,491	5,545,500	-	5,545,500
セグメント間の内部 売上高又は振替高	-	216,580	216,580	△216,580	-
計	5,107,008	655,072	5,762,080	△216,580	5,545,500
セグメント利益	1,386,332	164,435	1,550,767	△469,459	1,081,308
セグメント資産	6,993,213	575,152	7,568,366	2,169,371	9,737,737
その他の項目					
減価償却費	306,459	15,597	322,056	4,262	326,319
減損損失	-	-	-	-	-
有形固定資産及び無 形固定資産の増加額	5,622,386	149,728	5,772,115	225	5,772,340

(注) 1. 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、ソーラー事業、半導体生産設備の買取・販売及び半導体の関連材料販売と技術コンサルティングであります。

2. 調整額は以下のとおりであります。

(1)セグメント利益の調整額△469,459にはセグメント間取引消去△116,094千円、各報告セグメントに配分していない全社費用△353,364千円が含まれております。

(2)セグメント資産の調整額は、各報告セグメントに配賦していない全社資産であります。

全社資産は主に報告セグメントに帰属しない現金及び預金並びに管理部門に係る資産等であります。

(3)減価償却費の調整額は、全社資産に係る減価償却費であります。

(4)有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、全社資産に係る増加額であります。

3.セグメント利益は連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

4.セグメント間の売上高は、第三者間取引価格に基づいております。

(1株当たり情報)

	前連結会計年度 (自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日)	当連結会計年度 (自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日)
1株当たり純資産額	300円54銭	485円54銭
1株当たり当期純利益金額	131円90銭	56円72銭
潜在株式調整後 1株当たり当期純利益金額	—	55円04銭

(注) 1. 前連結会計年度の潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、新株予約権の残高がありますが、当社株式は非上場であり、期中平均株価が把握できないため記載しておりません。

2. 当社は平成26年8月12日開催の取締役会決議により、平成26年9月9日付で普通株式1株につき500株の株式分割を行っております。前連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して1株当たり純資産額、1株当たり当期純利益金額を算定しております。

3. 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目	前連結会計年度 (自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日)	当連結会計年度 (自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日)
1株当たり当期純利益金額		
当期純利益(千円)	664,261	304,248
普通株主に帰属しない金額(千円)	—	—
普通株式に係る当期純利益(千円)	664,261	304,248
普通株式の期中平均株式数(株)	5,036,164	5,364,251
潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額		
当期純利益調整額(千円)	—	—
普通株式増加数(株)	—	163,986
(うち新株予約権(株))	—	163,986
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要	第1回新株予約権 平成26年6月16日決議 197,000株	第2回新株予約権 平成27年6月19日決議 100,000株 第3回新株予約権 平成27年6月19日決議 153,000株

(注) 当社株式は、平成27年3月24日をもって、東京証券取引所マザーズ市場に上場しているため、当連結会計年度の潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額は、新規上場日から当連結会計年度までの平均株価を期中平均株価とみなして算定しております。

(重要な後発事象)

該当事項はありません。